
IDM



本报告仅供
report@wind.com.cn
邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。

➤

➤

➤

➤

➤

➤

1.1	+	6
1.2		6
1.3		7
2.1		8
2.2		18
3.1.		20
3.2.	IDM	25
3.3.		28
3.4.		30
4.1.		32
4.2.		33

1	6	
2	2022 Q1	7
3		7
4	&	8
5		8
6		8
7		8
8		9
9		9
10		9
11	2019	10
12	MOSFET	10
13	P N MOSFET	10
14	MOSFET	11
15	MOSFET	11
16	MOSFET /	11
17	MOSFET	11
18	MOSFET 2020	12
19	MOSFET 2020	12
20	2021	12
21	2021	12
22	600V/0.16Ω MOSFET	13

23	60V	MOSFET	13	
24		IGBT	13	
25		MOSFET	2020-2026	14
26	2020-2026	MOSFET	14	
27		Si MOSFET/IGBT/SiC MOSFET	15	
28			15	
29			15	
30	2020	IGBT	16	
31	2020-2026	IGBT	16	
32			17	
33			17	
34			17	
35			17	
36	2021-2027	SiC	17	
37			18	
38			18	
39			18	
40			19	
41			19	
42			19	
43			19	
44			20	
45			21	
46			21	
47		6	8	22
48				22
49				22
50				23
51				23
52				23
53				24
54				24
55				24
56		IPM	25	
57		Copper Clip	25	
58			25	
59			25	
60			25	
61			26	
62			26	
63			26	
64		MOSFET	2021	28
65				28
66				28
67				29
68				29
69		&	&ROE	30

70	31
71 /	31
72	32
73	32
74	33
75	FCFF	33
76	34

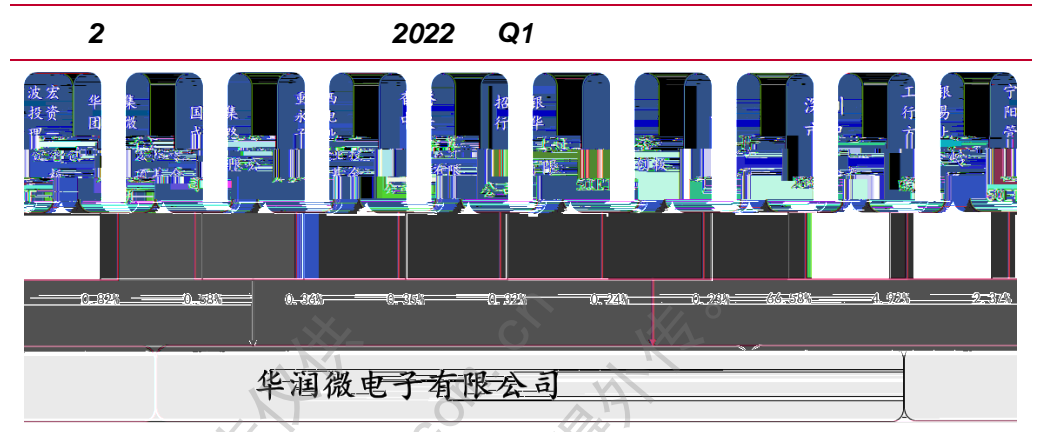
本报告仅供
report@wind.com.cn
邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。

1. IDM

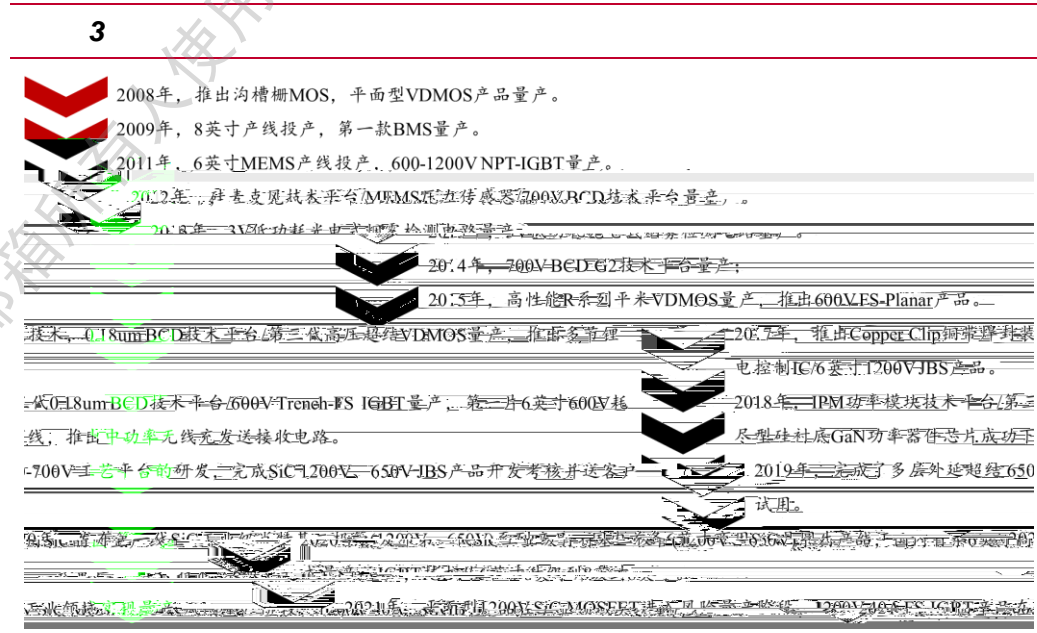
1.1

1

1.2



1.3



4

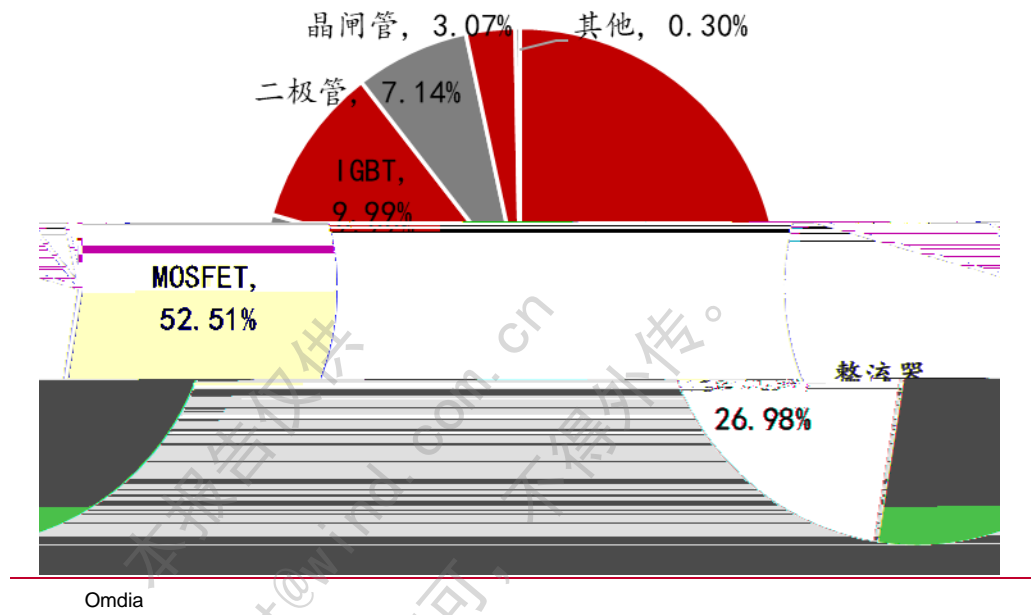
&

5

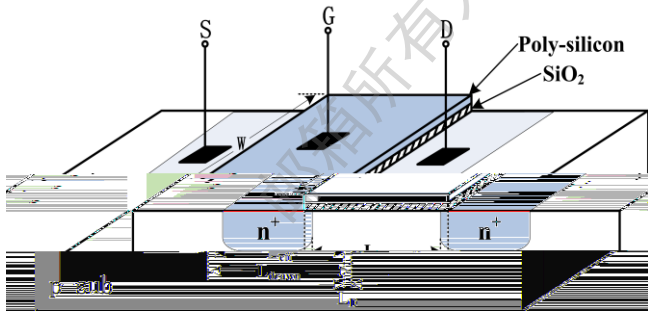
2.

2.1

11 2019

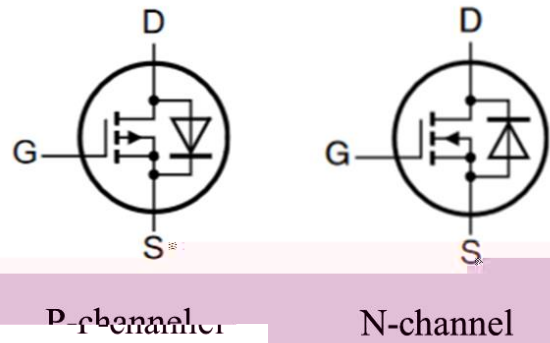


12 MOSFET

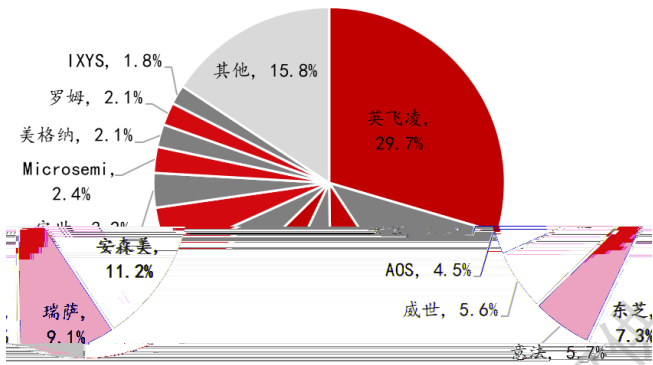


cnblogs

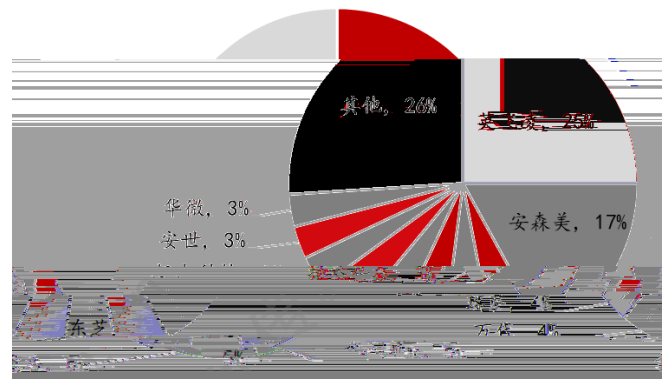
13 P N MOSFET



18 MOSFET 2020

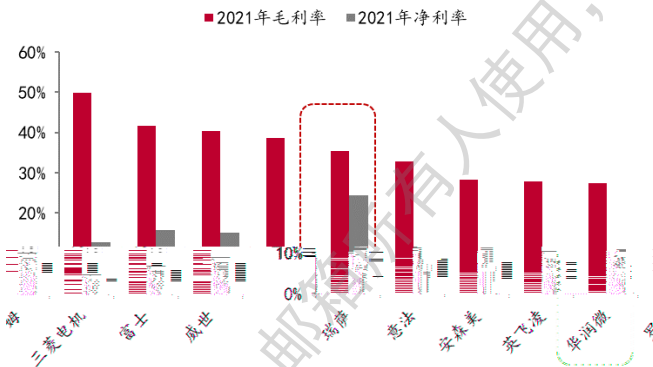


19 MOSFET 2020



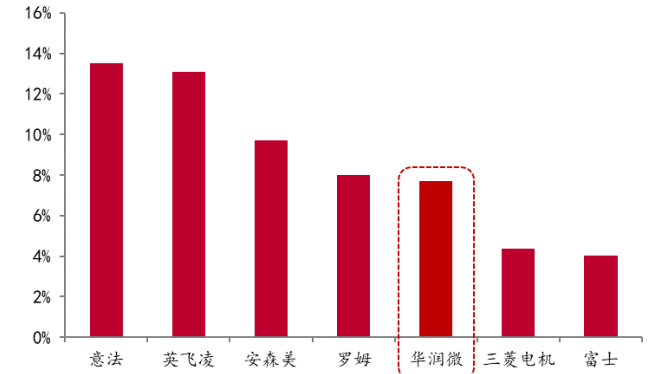
Omdia

20 2021



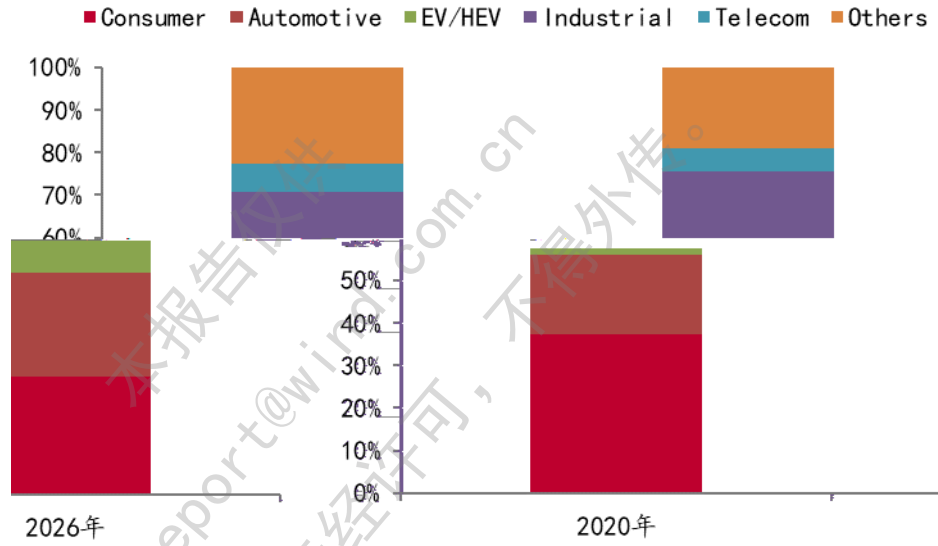
Wind

21 2021



Wind

25 MOSFET 2020-2026



Yole

26 2020-2026 MOSFET

Yole

27 Si MOSFET/IGBT/SiC MOSFET

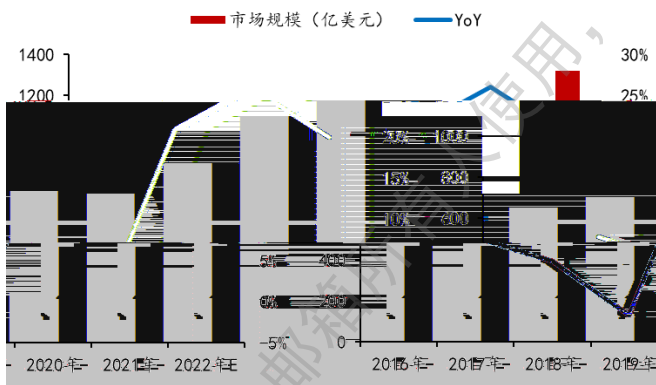
30 2020 IGBT

31 2020-2026 IGBT

2.2

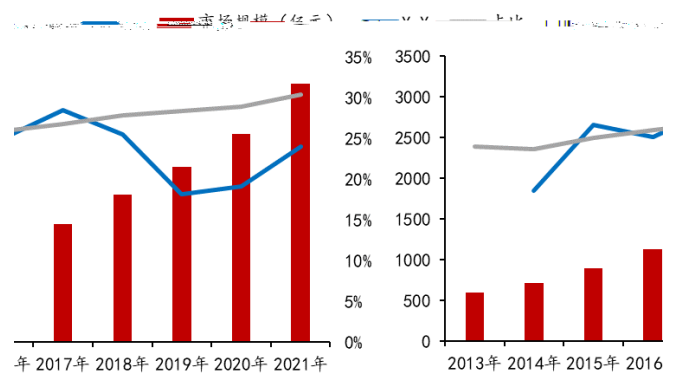
本报告仅供
report@wind.com.cn
未经许可，不得外传。

37

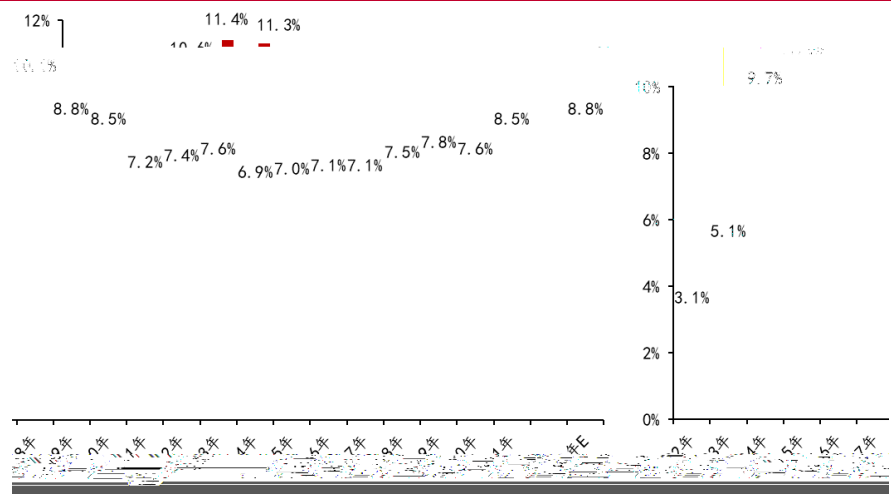


IC Insights

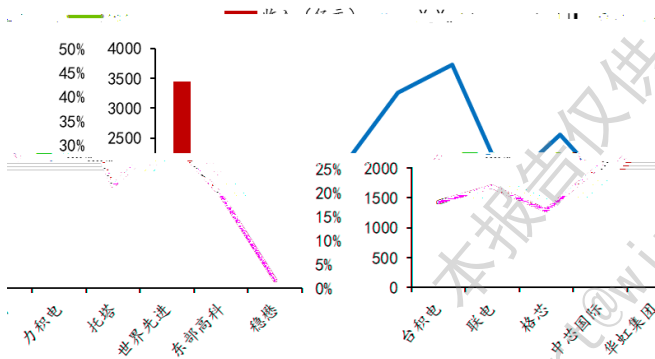
38



39

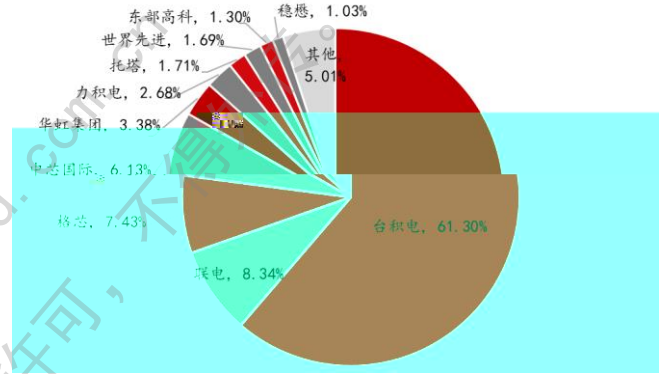


40 2021



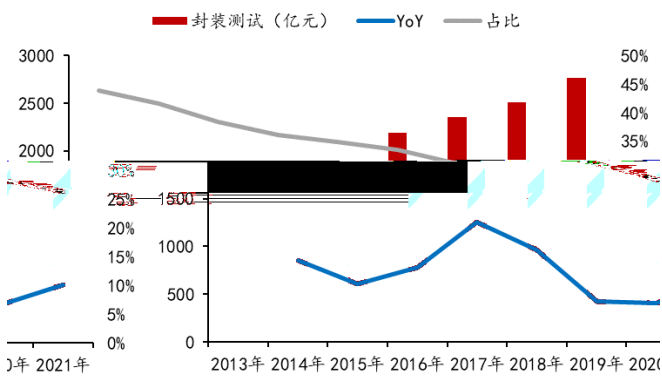
ChipInsights

41 2021

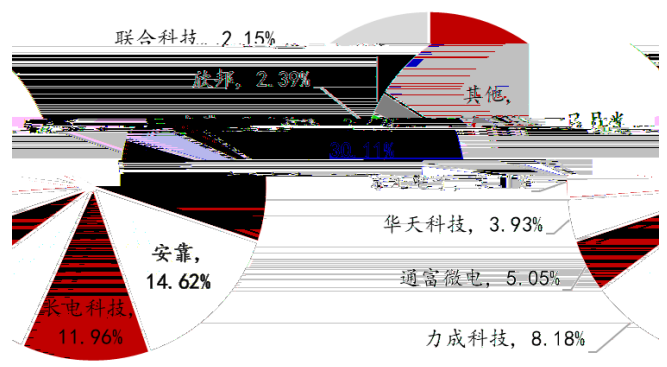


ChipInsights

42



43

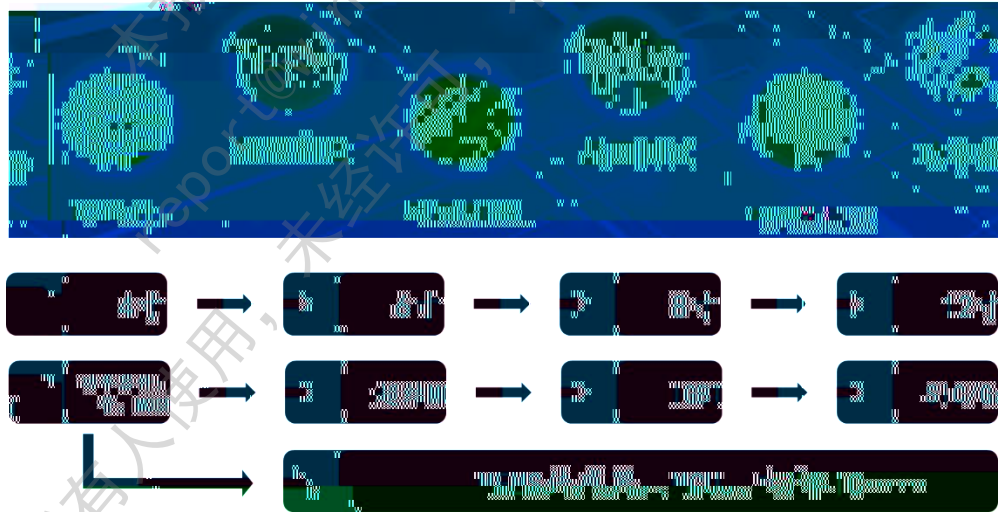


ChipInsights

3.

44

全产业链一体化运营能力



3.1.

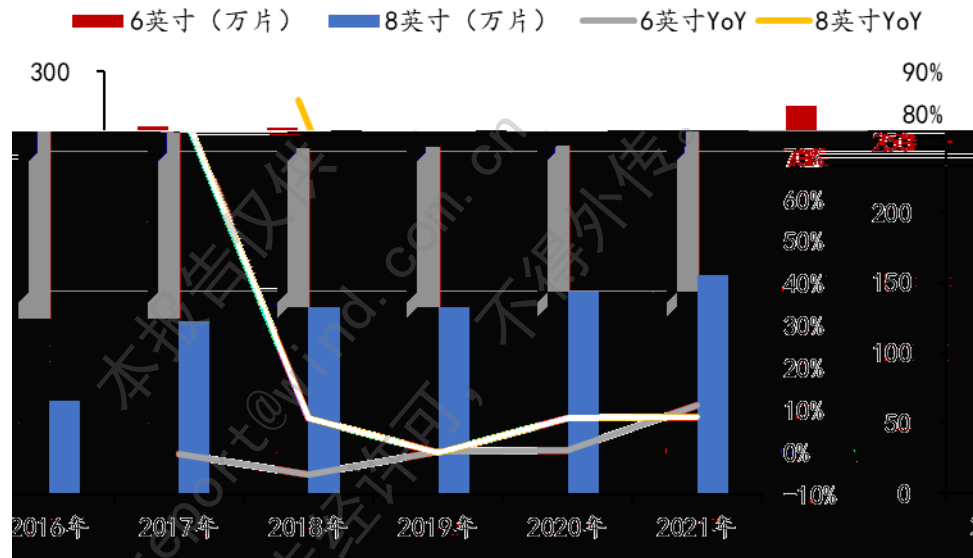
45

46

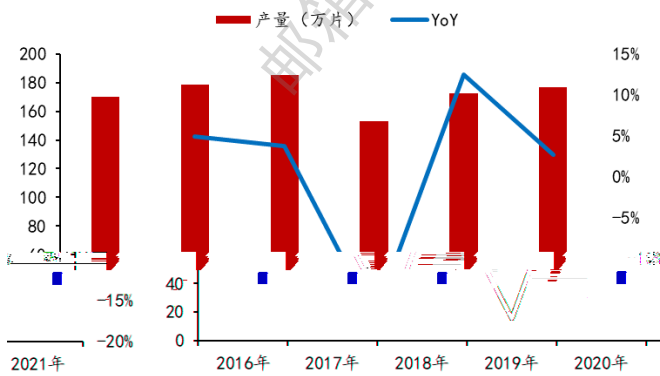
47

6

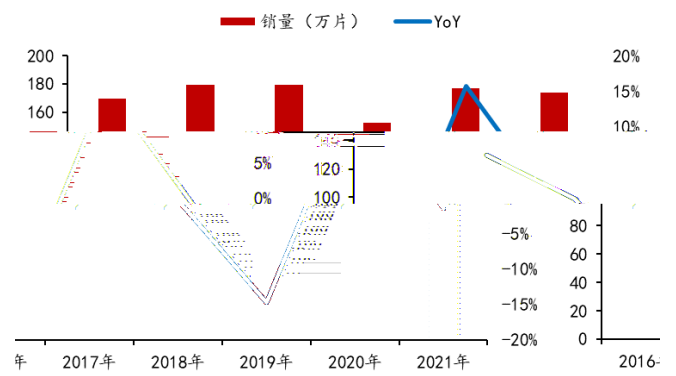
8



48



49



50

产品

- 0.18um 艾司普 (epp) 系统 (5: 14: 1) (OZ)
- 0.13um 艾司普 (epp) 系统 (5: 13: 1) (OZ)
- 0.13um "A5" 艾司普 (epp) 系统 (5: 13: 1) (OZ)
- 1:1 Array 蚀刻
- 深紫外光刻

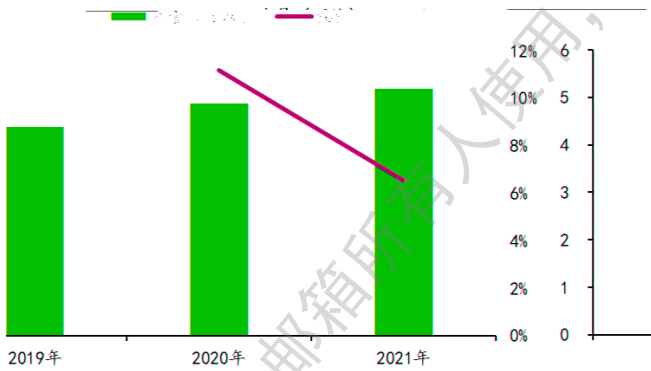
服务

- 提供 Job Deck View
- 制程稳定性 (MIP)
- 晶圆缺陷检测
- 提供制程数据支持
- 提供制程支持

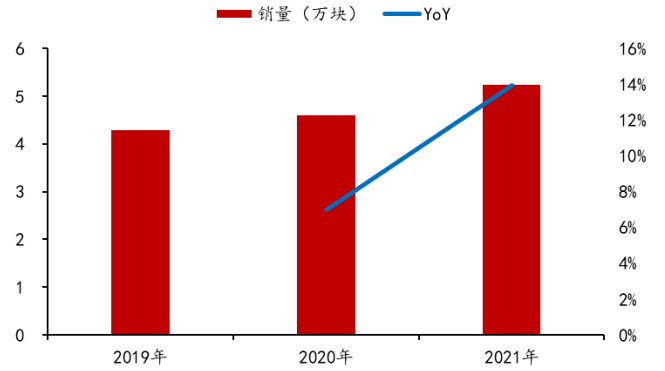
工艺

- 激光及电子束刻蚀工艺
- PSM 工艺
- OPR 工艺
- 干式蚀刻 (Dry Etch)

51



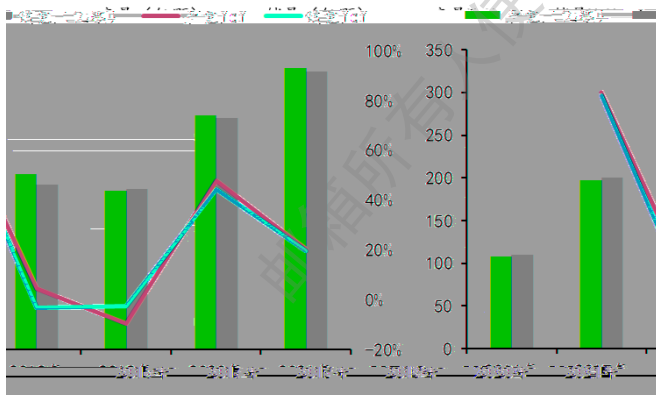
52



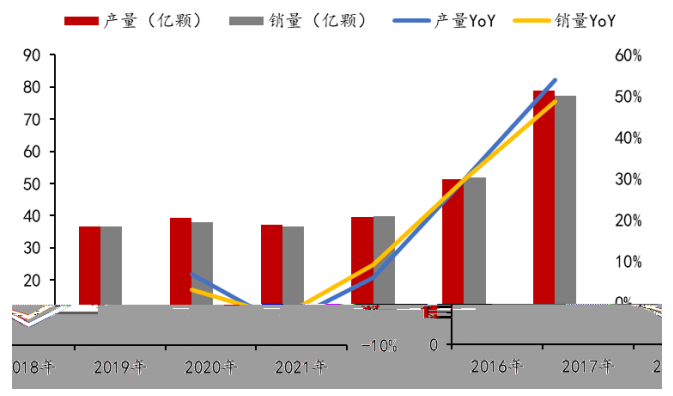
53

晶圆测试	封 装			成品测试		
深圳赛美科	无锡安盛	重庆矽磐	深圳赛美科	东莞杰群	深圳赛美科	无锡安盛
						
国内前三大晶圆测试厂	高可靠性传统IC封装	先进面板封装	光耦和硅麦等sensor封装	聚焦功率电子封装业务	各类产品成品测试	中高端成品测试
销售额：3.5亿	销售额：7.5亿	成立：2016.11	和客户合作一起	Modules, MOS-FETs / IGBTs, Drivers, IPMs, Controllers. 拥有独特的技术优势、知名的管理团队和全球高质量的功率器件封装产	200台套成品测试	年产出21亿颗
220+晶圆测试	IPM module	引进国际先进面板封装工艺	开发相应的灌封			220台套测试设备
10ea激光修调	QFN, LQFP, TSSOP, SSOP, SOT, SOP	供高能低成本封装方案,用于功率产品大规模封装,可替代传统QFN, LGA	市场需求的各类sensor			高温, 常温, 低温测试能力, 高端工业控制, 汽车电子测试要求
高温测试						
12": 2万片/年						
8"+6": 120万片/年	ECOL package					

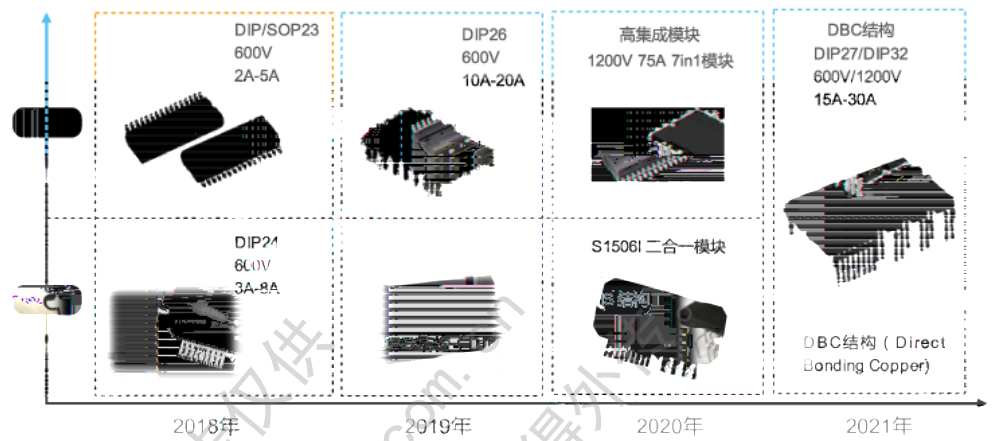
54



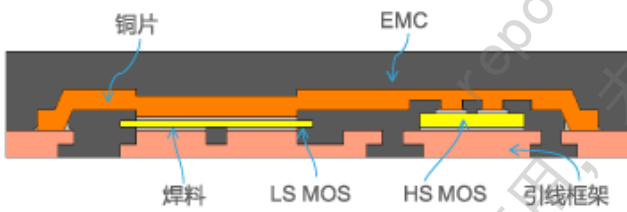
55



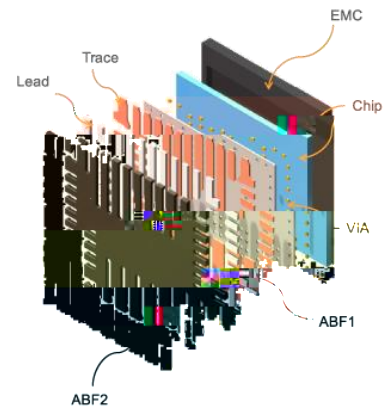
56 IPM



57 Copper Clip



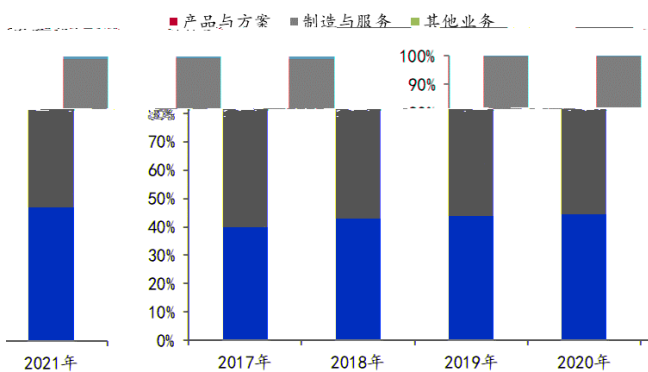
58



3.2.

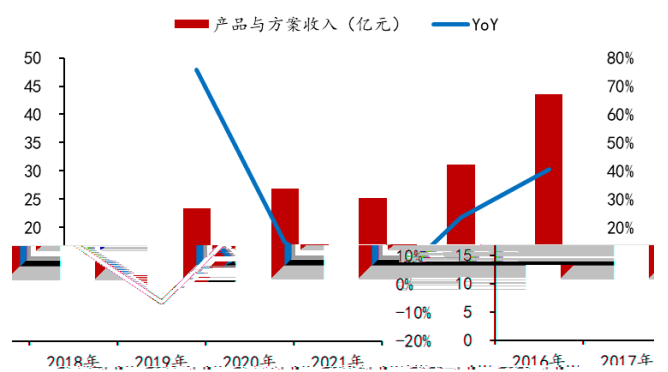
IDM

59

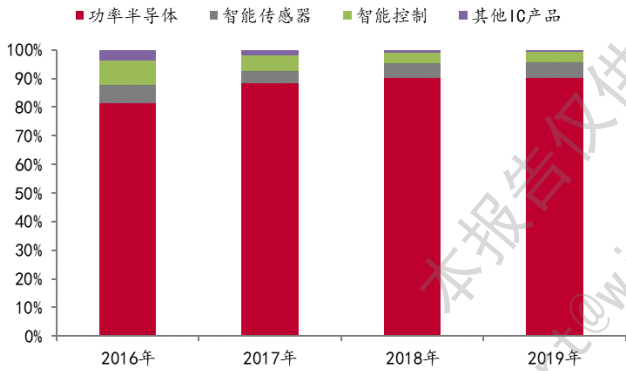


60

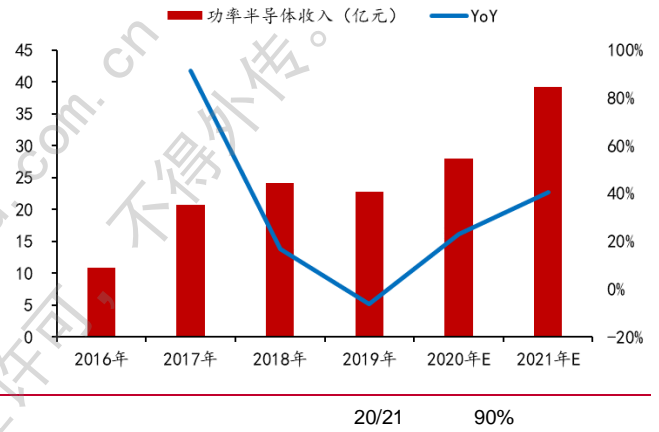
&



61



62



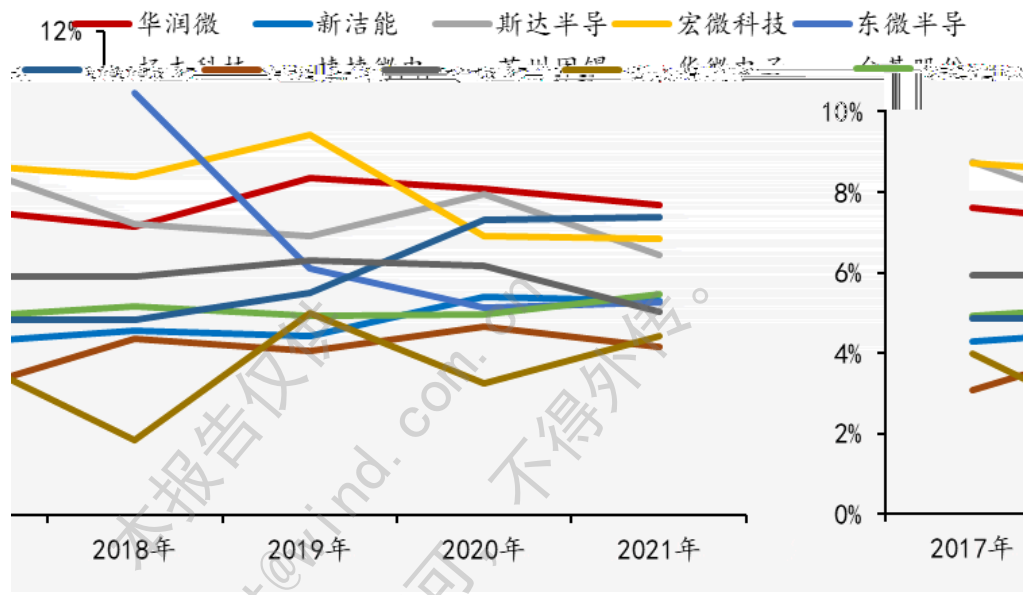
63

本报告仅供
report@wind.com.cn
邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。



[Redacted main body text]

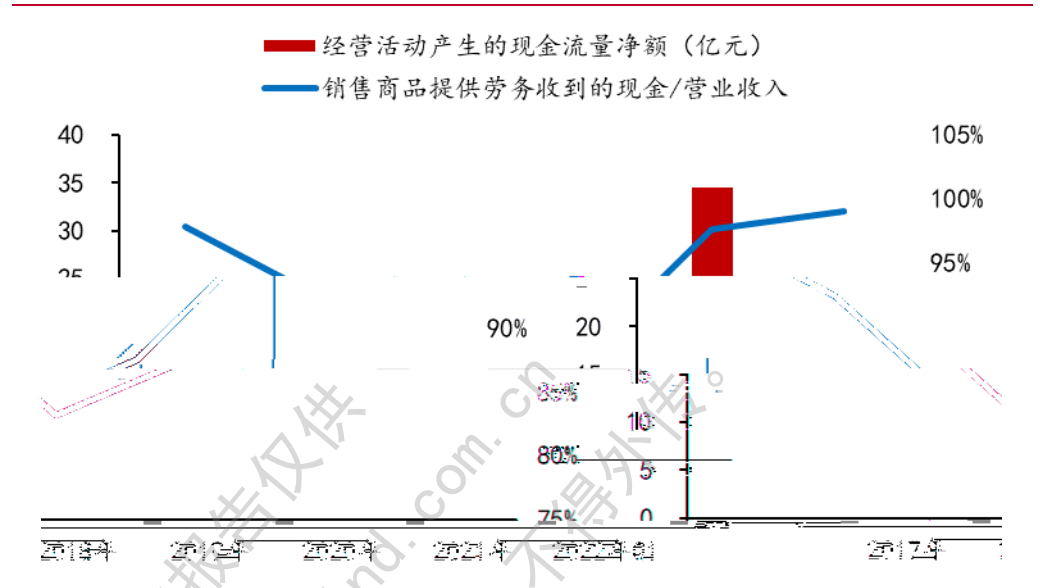
67



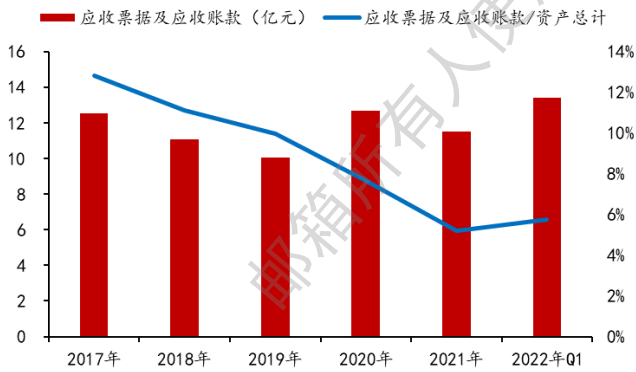
Wind

report@wind.com.cn
不得外传。
邮箱所有人使用，未经许可

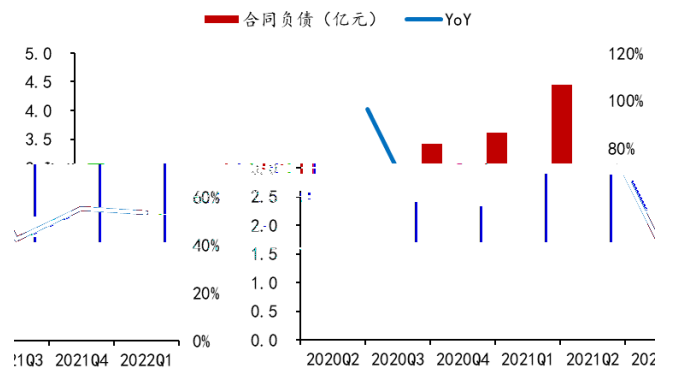
68



72



73



4.

4.1.

5.



本报告仅供
report@wind.com.cn
邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。

	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

--	--	--	--